

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平10-125929

(43) 公開日 平成10年(1998) 5月15日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

F I

H 0 1 L 29/786

H 0 1 L 29/78

6 2 7 Z

21/336

C 2 3 F 4/00

A

C 2 3 F 4/00

H 0 1 L 29/78

6 2 7 D

審査請求 未請求 請求項の数30 O L (全 13 頁)

(21) 出願番号 特願平8-300371

(71) 出願人 000002369

(22) 出願日 平成8年(1996)11月12日

セイコーエプソン株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

(31) 優先権主張番号 特願平8-225643

(72) 発明者 下田 達也

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

(32) 優先日 平8(1996)8月27日

ーエプソン株式会社内

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(72) 発明者 井上 聡

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエプソン株式会社内

(72) 発明者 宮沢 和加雄

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエプソン株式会社内

(74) 代理人 弁理士 鈴木 喜三郎 (外2名)

(54) 【発明の名称】 剥離方法

(57) 【要約】

【課題】被剥離物の特性、条件等にかかわらず、容易に剥離することができ、特に、種々の転写体への転写が可能なる剥離方法を提供すること。

【解決手段】本発明の剥離方法(転写方法)は、透光性の基板1上に例えば非晶質シリコンよりなる光吸収層21と金属薄膜よりなる反射層22との積層体である分離層2を形成する工程と、分離層2上に直接または所定の中間層3を介して被転写層4を形成する工程と、被転写層4の基板1と反対側に接着層5を介して転写体6を接合する工程と、基板1の裏面側から分離層2にレーザー光のような照射光7を照射し、光吸収層21にアブレーションを起こさせ、分離層2の層内および/または界面において剥離を生ぜしめ、被転写層4を基板1から離脱させて転写体6へ転写する工程とを有する。

